

2020年度 第3四半期 決算説明資料

2021.1.26

将来の見通しに関する注意事項

このプレゼンテーションに掲載されている当社の現在の計画、見通し、戦略、その他の歴史的事実でないものは、将来の業績に関する見通しであり、これらは現在入手可能な情報から得られた当社の経営者の判断に基づいております。

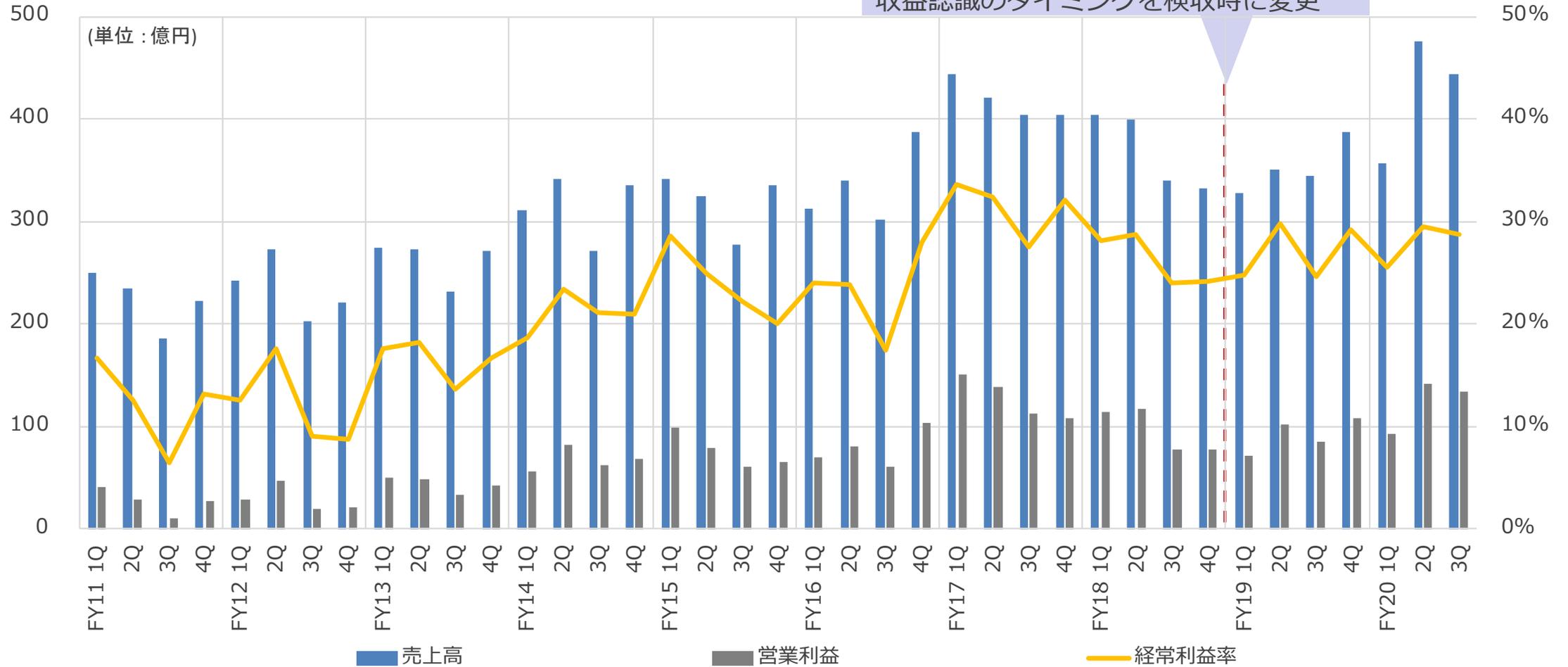
実際の業績は、さまざまな重要な要素により、これらの業績見通しとは大きく異なる結果となりうることをご承知おきください。

実際の業績に影響を与える重要な要素には、世界・日本経済の動向、急激な為替相場の変動ならびに戦争・テロ活動、災害や伝染病の蔓延等があります。

(単位：百万円)	FY2020	FY2020	QoQ		FY2019	YoY	
	3Q	2Q	差額	(%)	3Q	差額	(%)
売上高	44,393	47,561	-3,168	-6.7%	34,435	9,958	28.9%
売上総利益	26,646	27,418	-772	-2.8%	21,036	5,609	26.7%
GP率	60.0%	57.6%	2.4p	-	61.1%	-1.1p	-
販売管理費	13,333	13,342	-9	-0.1%	12,598	735	5.8%
営業利益	13,313	14,076	-763	-5.4%	8,438	4,875	57.8%
経常利益	12,761	14,008	-1,247	-8.9%	8,492	4,269	50.3%
経常利益率	28.7%	29.5%	-0.8p	-	24.7%	4.0p	-
税 前 利 益	12,652	14,007	-1,355	-9.7%	8,734	3,918	44.9%
純 利 益	9,026	10,127	-1,101	-10.9%	6,333	2,693	42.5%

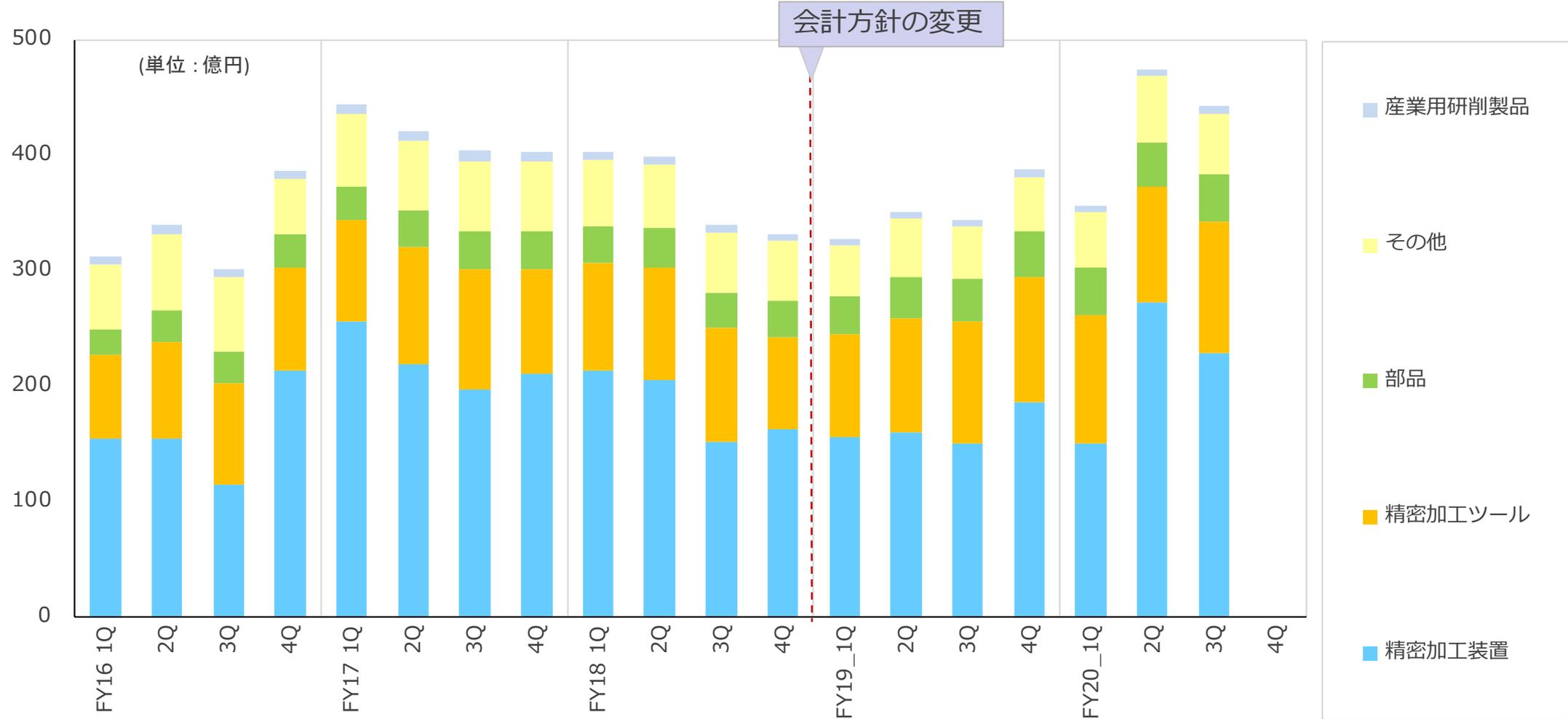
売上高： QoQ 装置減少、消耗品増加 YoY 装置大幅増加、消耗品増加
 GP率： 製品構成の変化などにより、QoQでは上昇 YoYでは低下
 販売管理費： QoQ 人件費および研究開発費が高水準横ばい

会計方針変更により
収益認識のタイミングを検収時に変更

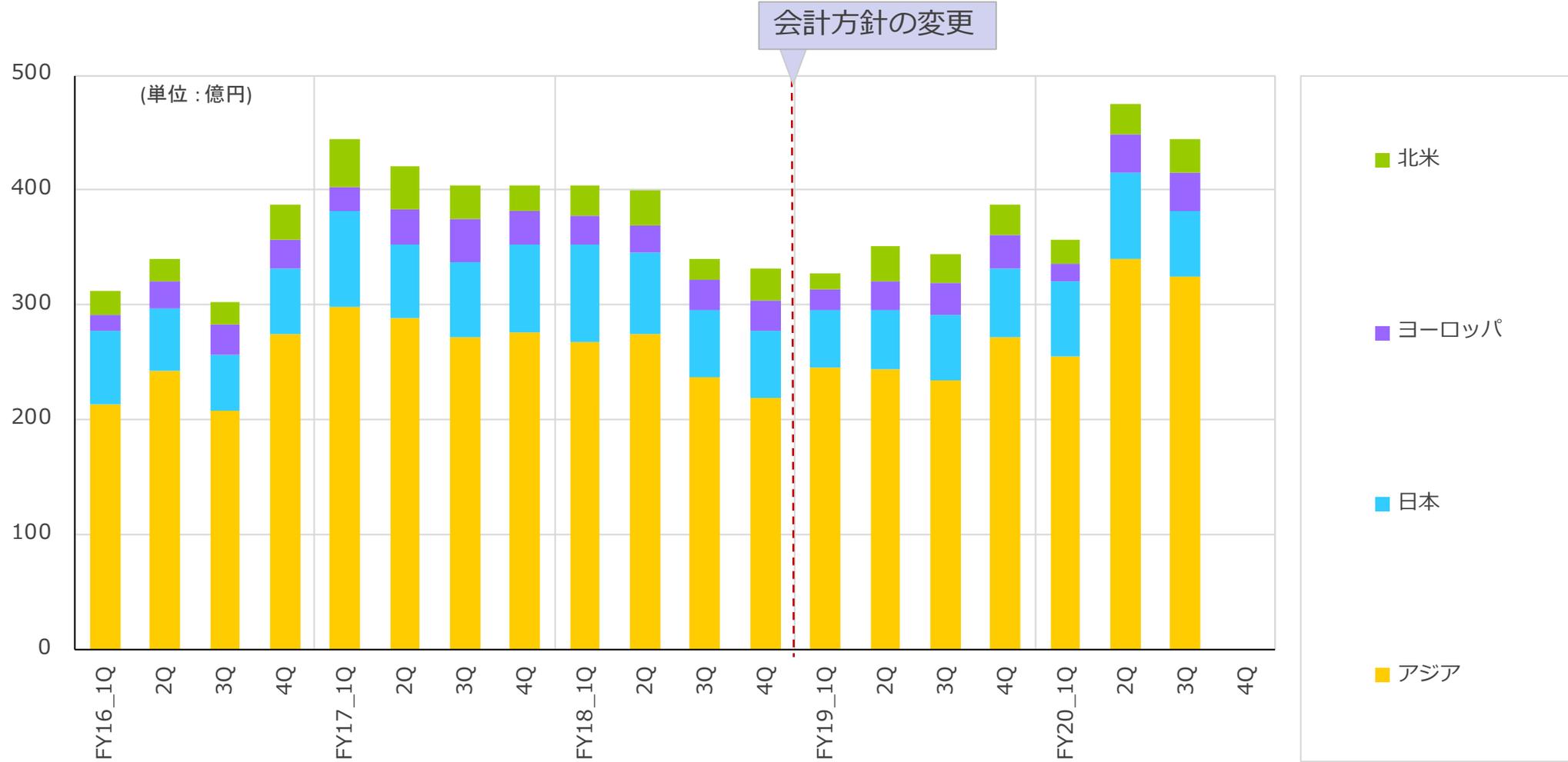


FY20_3Q 営業利益率30.0% 経常利益率28.7% 純利益率20.3%

製品群別売上高 四半期推移

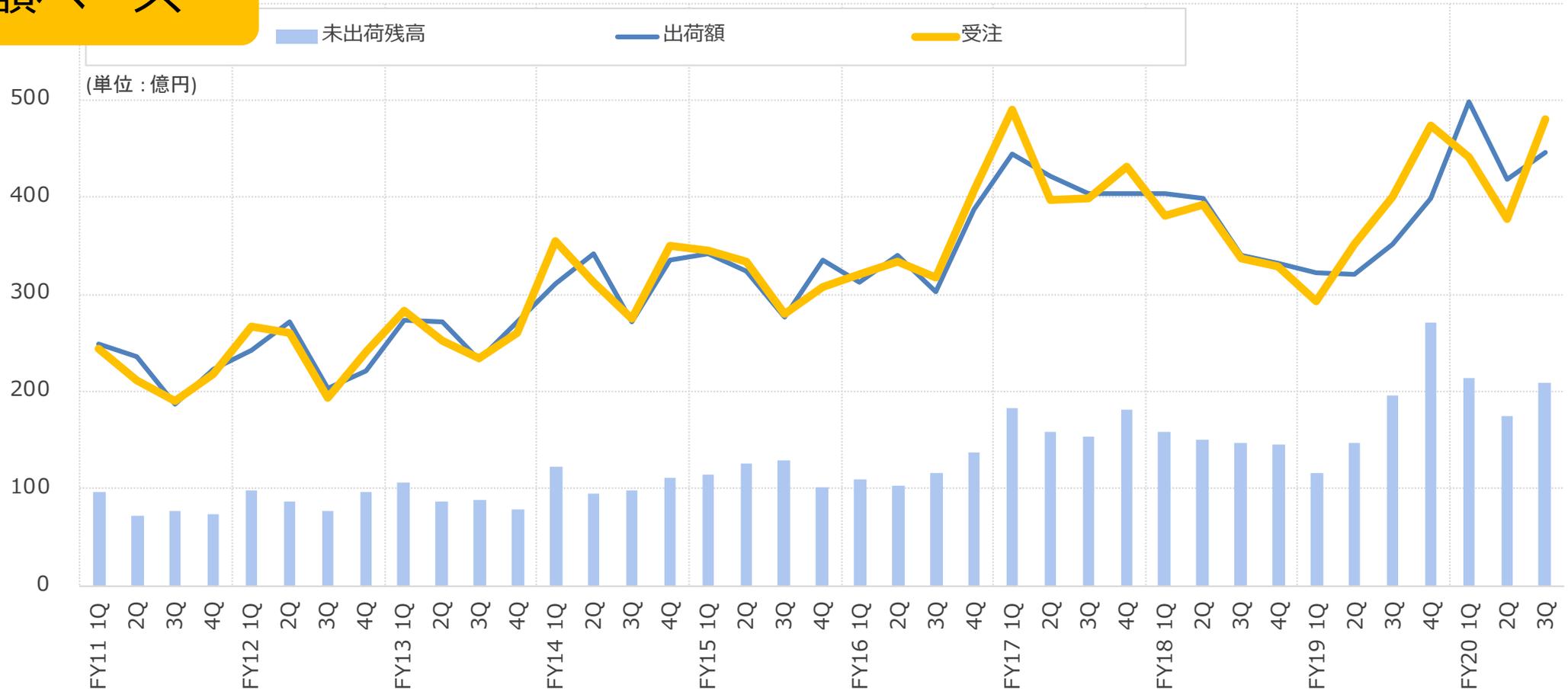


※構成比数値は、Webサイト「補足情報」に記載



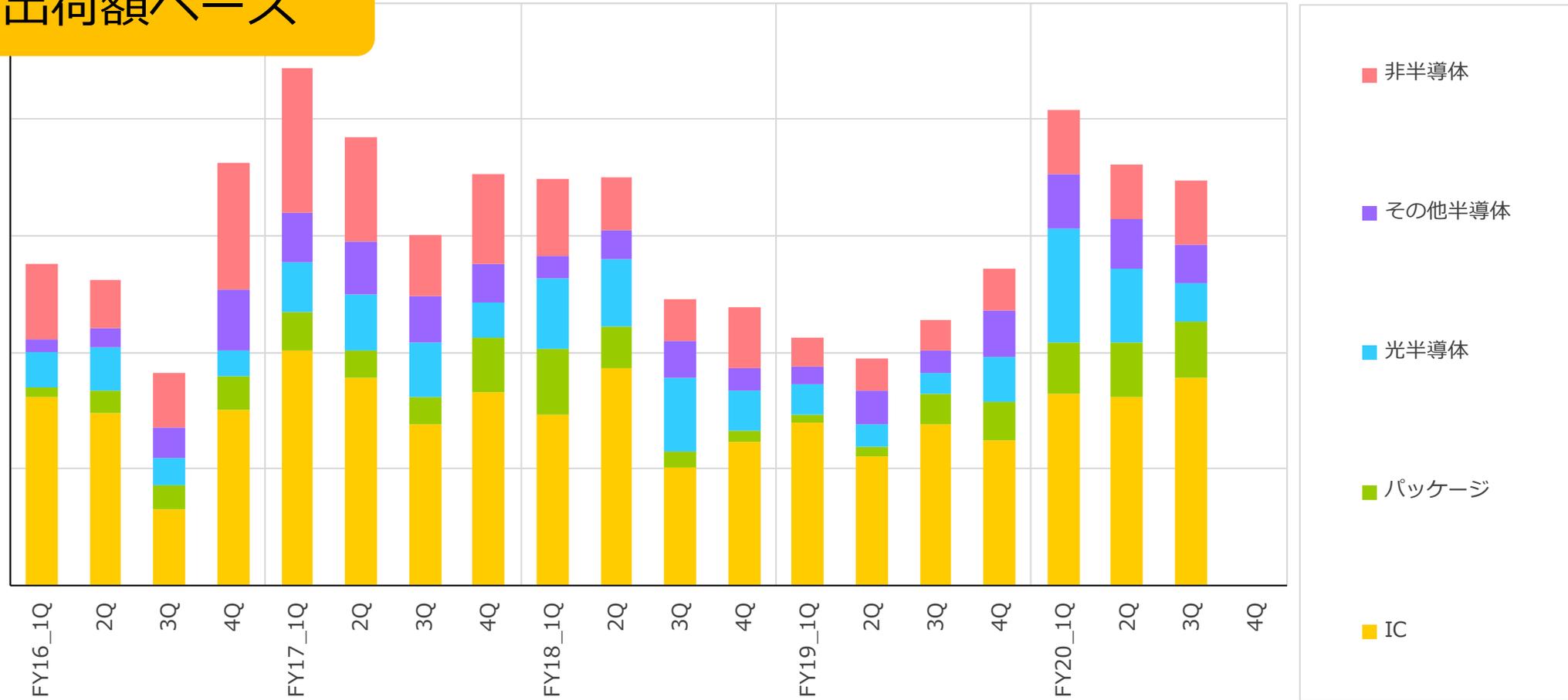
FY20_3Q 海外売上高比率 87.4%

出荷額ベース



FY20_3Q 受注高 約480億円、出荷額 約446億円、未出荷残高 約209億円

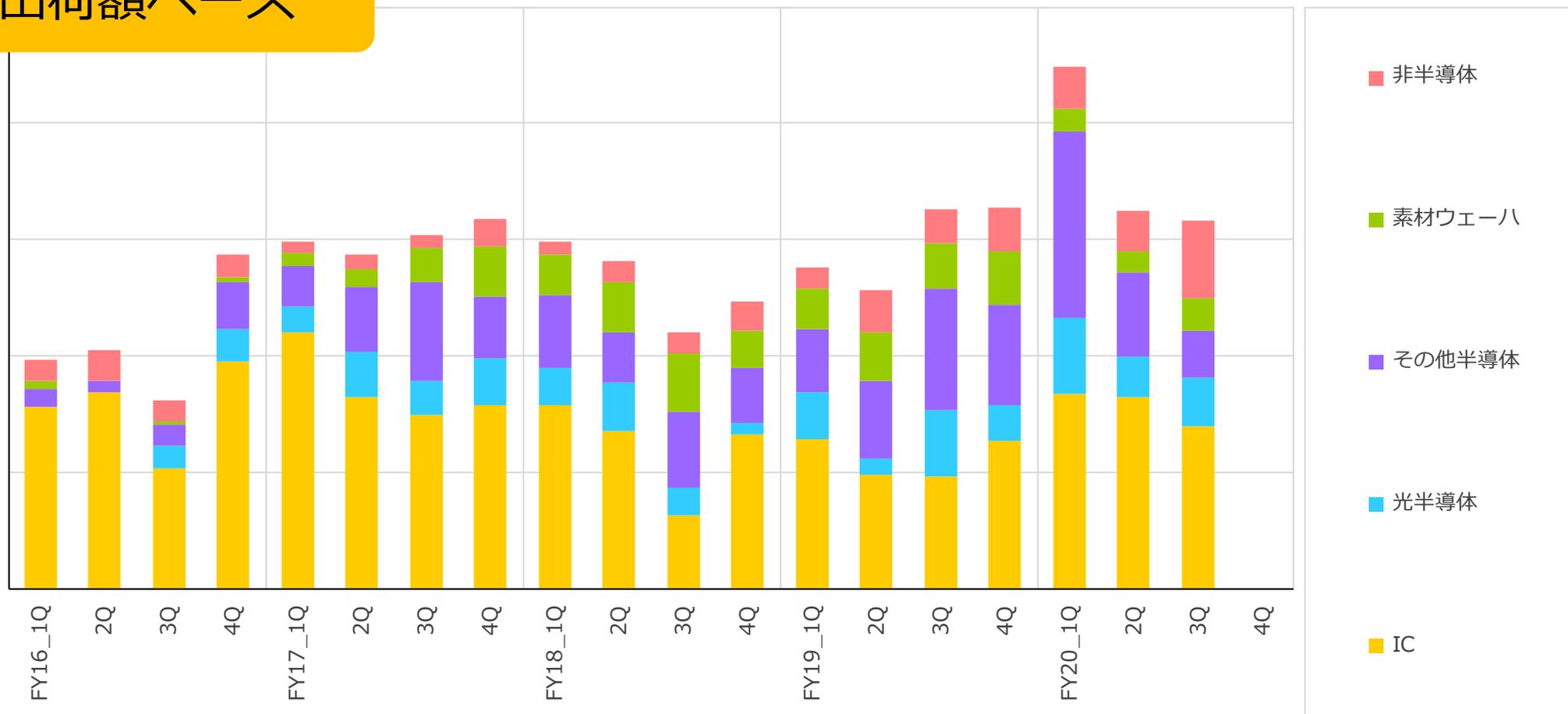
出荷額ベース



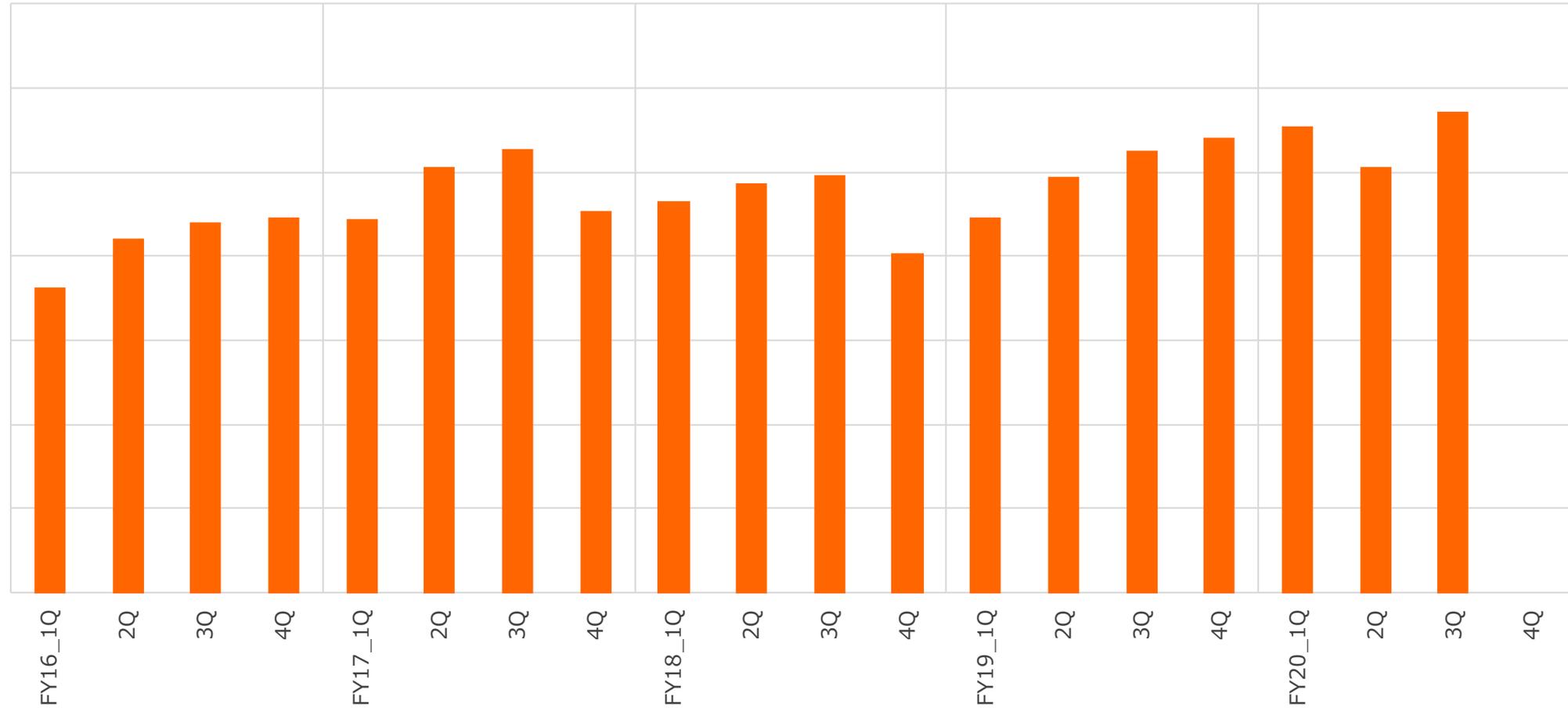
QoQ
YoY

堅調なIC向けに加え、非半導体の伸びが全体を下支え
5G関連需要の拡大を背景に、IC向けを中心とした量産用途が高水準で推移

出荷額ベース



QoQ 高周波デバイスと中心とする非半導体の増加が全体を下支え
 YoY 薄化需要の拡大を背景に、ほぼすべての用途で増加



顧客の高い設備稼働率などを背景に消耗品の出荷は堅調に推移

(単位：百万円)	FY2020 3Q	FY2020 2Q	差額
現金及び預金	90,947	90,256	691
受取手形・売掛金	30,114	30,273	-159
たな卸資産	55,454	53,168	2,286
流動資産	184,292	179,231	5,061
有形固定資産	105,086	99,090	5,997
固定資産	115,185	109,492	5,693
総資産	299,478	288,723	10,754
流動負債	62,098	56,850	5,248
固定負債	549	555	-6
負債合計	62,648	57,405	5,243
純資産	236,829	231,317	5,512
負債純資産合計	299,478	288,723	10,754
自己資本比率	78.7%	79.7%	-1.0p

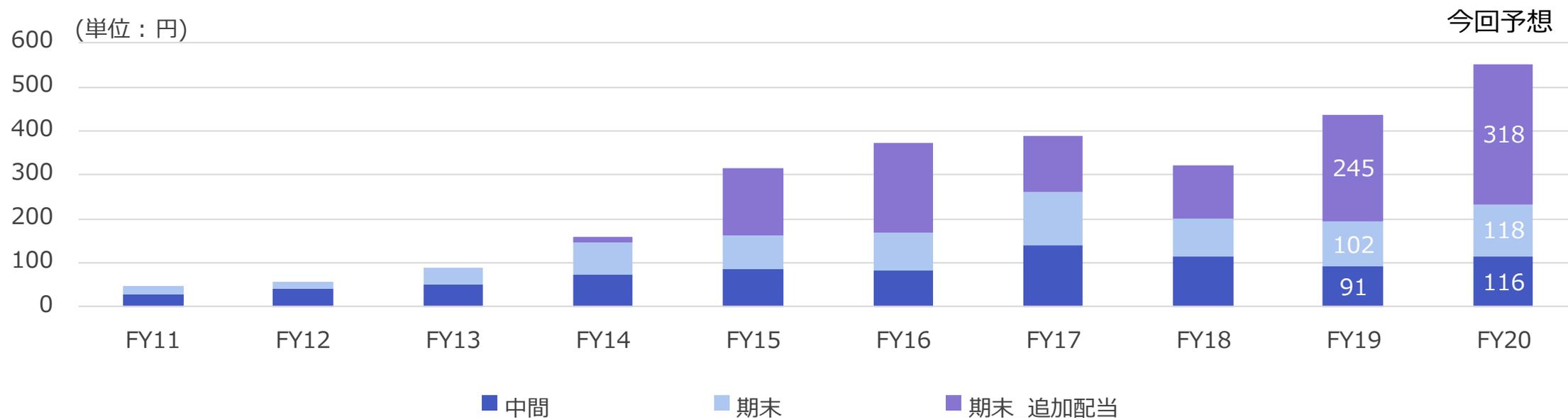
総資産：高水準の引き合いに対応するため、たな卸資産が増加
 負債：主に買掛金で流動負債が増加
 純資産：主に利益剰余金の増加

固定資産は工場拡張による増加

【配当方針】

1. 期末、中間の年2回、連結半期純利益の25%を配当する
2. 安定配当として半期10円（年間20円）を維持。ただし3期連続で連結純損失の場合を除く
3. 期末時点で赤字の場合を除き、配当及び法人税支払い後の現預金残高が予定必要資金額(*)を超過した場合は、上記1.に加え、超過金額の3分の1を目処に配当に上乗せする（追加配当）

*技術購入予備費（技術特許購入、ベンチャーへの出資等）および設備拡張資金、有利子負債返済資金など



今期予想	FY20	中間	116円 (実績)	FY20	期末	436円 (内 追加配当318円)
前期実績	FY19	中間	91円	FY19	期末	347円 (内 追加配当245円)

(単位：億円)

今回予想

	FY19 1Q	2Q	3Q	4Q	FY20 1Q	2Q	3Q	4Q
売上高	328	351	344	388	357	476	444	437
営業利益	71	101	84	108	93	141	133	107
経常利益	81	104	85	113	91	140	128	110
純利益	57	73	63	83	65	101	90	80
営業利益率	21.7%	28.8%	24.5%	27.8%	26.0%	29.6%	30.0%	24.6%
経常利益率	24.7%	29.7%	24.7%	29.1%	25.6%	29.5%	28.7%	25.2%
純利益率	17.5%	20.8%	18.4%	21.3%	18.2%	21.3%	20.3%	18.2%
出荷額	322	320	352	399	499	418	446	494

※億円未満 四捨五入

FY19より売上計上を「検収時」へ変更

想定為替レート

US\$: 95円

Euro : 120円

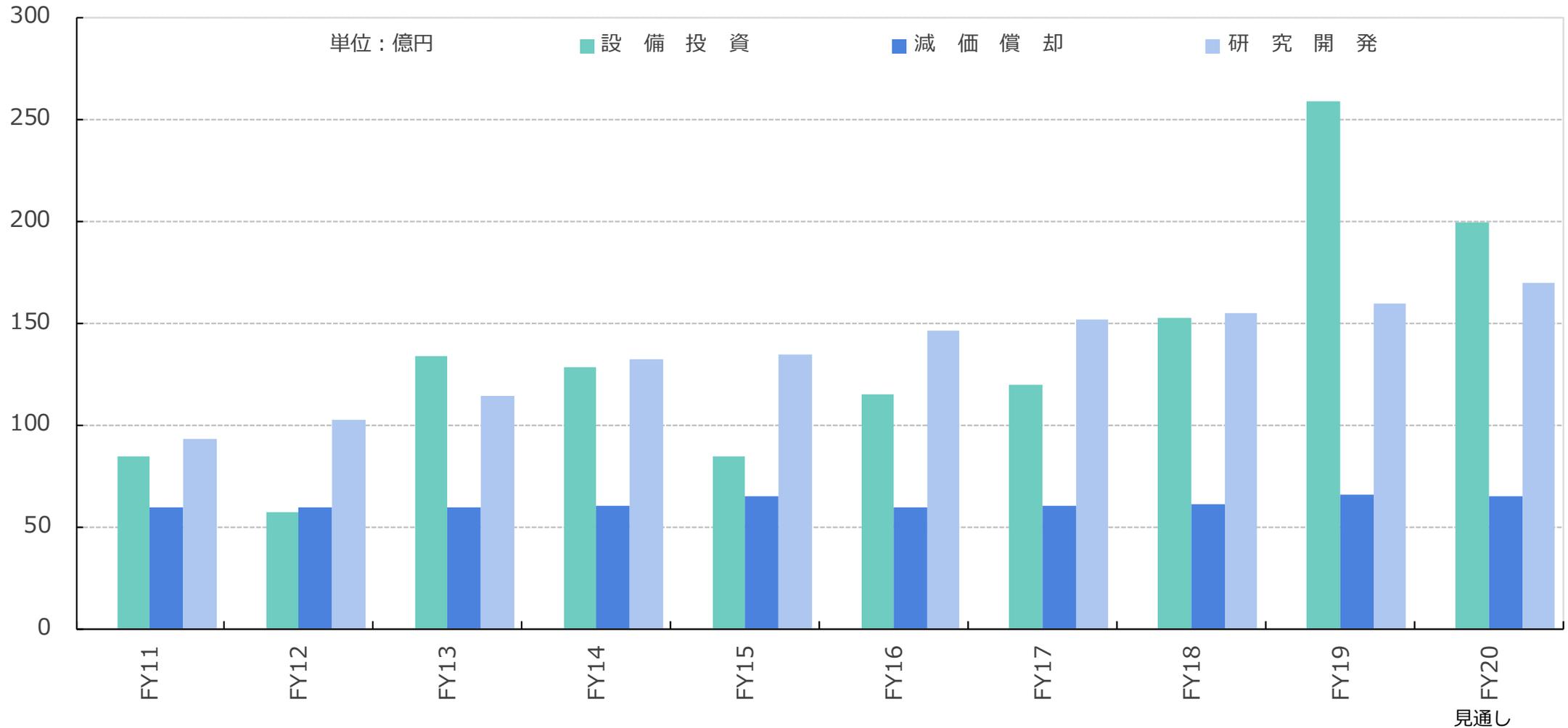
為替感応度 (連結 年換算)

US\$: 約7-8億円

Euro : 約3千万円

出荷額ベース

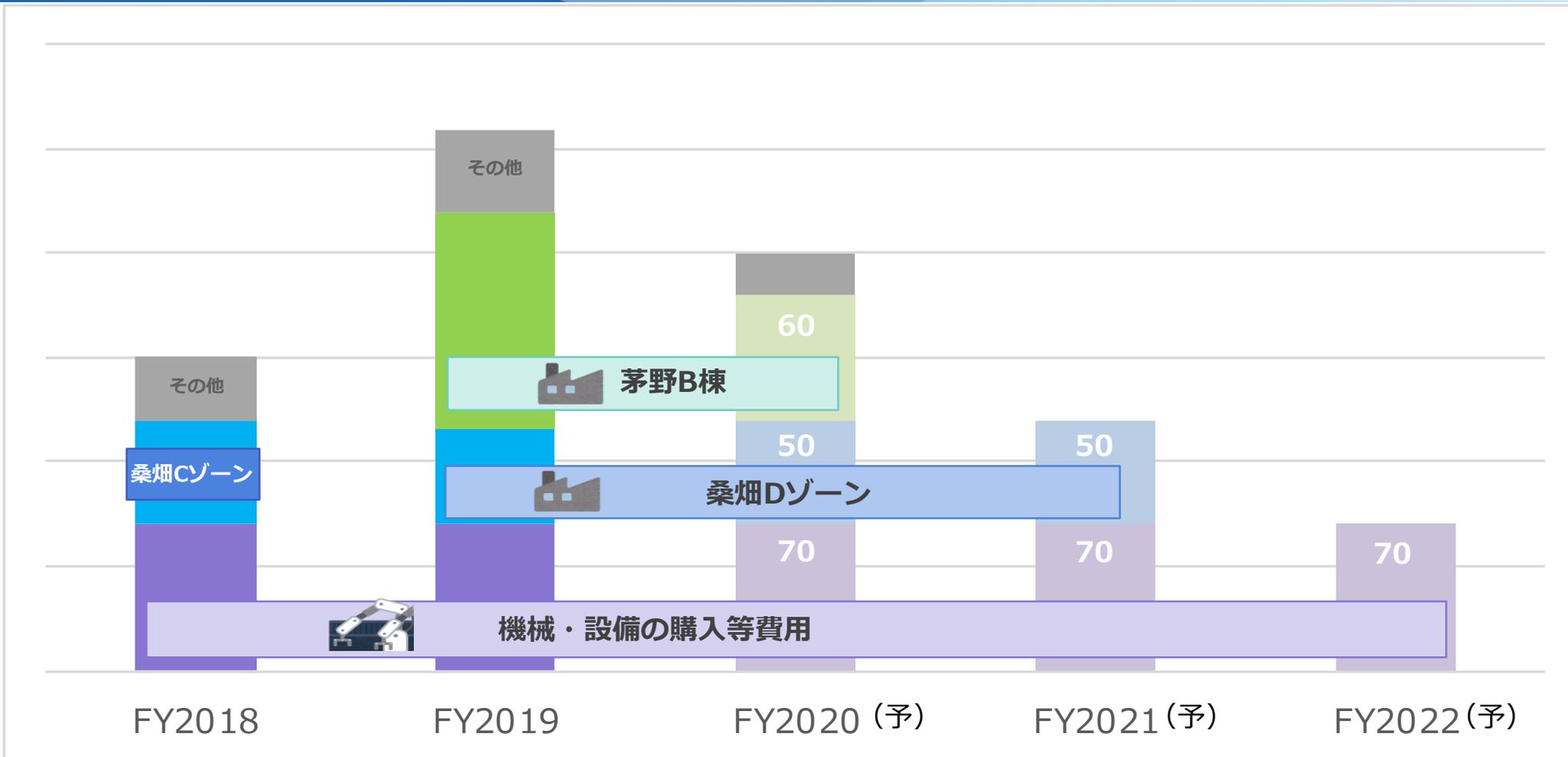
QoQ		FC FY20_4Q
精密加工装置	薄化DGP	20%
	薄化以外	40%
	グラインダ	30%
	ブレードダイサ	30%
	レーザソー	50%
ダイサ	40%	
精密加工装置		40%
精密加工ツール		-10%
その他		-20%



FY20見通し

設備投資：工場新棟建設（桑畑と茅野）を含む	200億円前後	（FY19実績 259億円）
減価償却：前年度並の償却を見込む	65億円前後	（FY19実績 66億円）
研究開発：積極的な研究開発を実施予定	170億円前後	（FY19実績 159億円）

単位：億円



FY20見通し

機械・設備の購入等費用
 桑畑工場 Dゾーン：工期見合いで1 / 3の支払
 茅野工場 B棟竣工に伴う支払い

70億円前後
 50億円前後
 60億円前後

- ご参考 製品群別 用途別 データ集

出荷額ベース

	構成比	QoQ	YoY
■ 連結	3Q	3Q	3Q
精密加工装置合計	49%	-3%	35%
装置の内ダイサ	33%	-3%	54%
ブレードダイサ	21%	-4%	57%
レーザソー	12%	0%	50%
装置の内グラインダ	16%	-1%	6%
薄化DGP	10%	-5%	18%
薄化以外	6%	8%	-9%
精密ダイヤ	26%	13%	10%
その他 合計	26%	22%	33%
出荷額合計	100%	7%	27%

出荷額ベース

構成比		2019年度				2020年度		
製品	用途	19-1Q	19-2Q	19-3Q	19-4Q	20-1Q	20-2Q	20-3Q
ダイサ	1_IC	66%	57%	61%	46%	40%	45%	51%
	2_パッケージ	4%	4%	11%	12%	11%	13%	14%
	3_光半導体	12%	10%	8%	14%	24%	17%	10%
	4_その他_半導体	7%	15%	8%	15%	11%	12%	10%
	5_非半導体	11%	14%	11%	13%	14%	13%	16%
ダイサ		100%						
グラインダ	1_IC	46%	38%	30%	39%	37%	51%	44%
	2_光半導体	15%	5%	17%	9%	14%	11%	13%
	3_その他_半導体	20%	26%	32%	26%	36%	22%	13%
	4_素材ウエーハ	12%	16%	12%	14%	4%	6%	9%
	5_非半導体	6%	14%	9%	11%	8%	11%	21%
グラインダ		100%						

出荷額ベース

YoY		2019年度				2020年度		
製品	用途	19-1Q	19-2Q	19-3Q	19-4Q	20-1Q	20-2Q	20-3Q
ダイサ	1_IC	-5%	-41%	37%	1%	18%	46%	28%
	2_パッケージ	-86%	-76%	94%	253%	466%	442%	91%
	3_光半導体	-59%	-67%	-71%	13%	293%	231%	82%
	4_その他_半導体	-21%	15%	-39%	96%	197%	52%	77%
	5_非半導体	-63%	-39%	-27%	-31%	128%	66%	113%
ダイサ		-39%	-44%	-7%	14%	92%	85%	53%
グラインダ	1_IC	-19%	-27%	54%	-4%	31%	67%	44%
	2_光半導体	27%	-67%	141%	199%	57%	156%	-25%
	3_その他_半導体	-13%	54%	59%	82%	196%	8%	-62%
	4_素材ウエーハ	-1%	-6%	-20%	44%	-44%	-55%	-29%
	5_非半導体	63%	107%	49%	53%	108%	-4%	131%
グラインダ		-8%	-9%	48%	33%	63%	27%	-3%

出荷額ベース

QoQ		2019年度				2020年度		
製品	用途	19-1Q	19-2Q	19-3Q	19-4Q	20-1Q	20-2Q	20-3Q
ダイサ	1_IC	13%	-21%	26%	-10%	32%	-2%	10%
	2_パッケージ	-17%	12%	187%	32%	34%	7%	1%
	3_光半導体	-27%	-24%	-3%	109%	154%	-36%	-47%
	4_その他_半導体	-23%	84%	-34%	109%	16%	-6%	-23%
	5_非半導体	-53%	15%	-8%	39%	55%	-16%	19%
ダイサ		-11%	-8%	17%	20%	50%	-11%	-4%
グラインダ	1_IC	-3%	-23%	-1%	31%	32%	-2%	-15%
	2_光半導体	299%	-67%	307%	-44%	109%	-46%	19%
	3_その他_半導体	15%	24%	56%	-18%	87%	-55%	-45%
	4_素材ウエーハ	6%	20%	-4%	18%	-59%	-4%	52%
	5_非半導体	-27%	106%	-20%	27%	-1%	-5%	93%
グラインダ		12%	-7%	27%	0%	37%	-28%	-3%

検収ベース

■構成比	FY2019				FY2020			
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q
日本	15%	15%	17%	15%	18%	16%	13%	
アメリカ	4%	9%	7%	7%	6%	6%	7%	
アジア	75%	70%	68%	70%	71%	71%	73%	
シンガポール	11%	10%	10%	8%	9%	7%	8%	
台湾	17%	19%	21%	21%	20%	23%	19%	
韓国	16%	19%	9%	10%	12%	10%	11%	
中国 ※	30%	20%	26%	30%	29%	27%	34%	
その他	1%	2%	2%	1%	1%	4%	2%	
ヨーロッパ	5%	7%	8%	8%	4%	7%	8%	
合計	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

※外資メーカー現地工場向け含む

■単純平均 / 為替レート		USD	EUR
FY18	18-1Q	108.1	129.9
	18-2Q	110.9	129.1
	18-3Q	113.4	129.9
	18-4Q	110.3	126.0
FY18_通期		110.7	128.8
FY19	19-1Q	110.8	123.6
	19-2Q	107.6	120.4
	19-3Q	108.8	119.9
	19-4Q	109.3	121.0
FY19_通期		109.1	121.3
FY20	20-1Q	107.8	118.2
	20-2Q	105.9	123.6
	20-3Q	104.8	123.6
	20-4Q	95.0	120.0

連結受注_月次推移	
2019年10月	133 億円
2019年11月	114 億円
2019年12月	154 億円
2020年1月	143 億円
2020年2月	133 億円
2020年3月	197 億円
2020年4月	187 億円
2020年5月	115 億円
2020年6月	139 億円
2020年7月	121 億円
2020年8月	121 億円
2020年9月	136 億円
2020年10月	143 億円
2020年11月	171 億円
2020年12月	167 億円